

# 大连达利凯普科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

## 特别提示

大连达利凯普科技股份有限公司(以下简称“达利凯普”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)(以下简称“《管理办法》”)(首次公开发行股票注册管理办法)(证监会令〔第205号〕)(以下简称“《注册办法》”)(《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100号))(以下简称“《业务实施细则》”)(《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号))(以下简称“《网下发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上〔2023〕110号))(以下简称“《网下发行实施细则》”)(《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号))(以下简称“《承销业务规则》”)(首次公开发行股票网下投资者管理规则)(中证协发〔2023〕19号))(以下简称“《网下投资者管理规则》”)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)(有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定,组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售在保荐人(主承销商)处进行;本次发行询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网下发行实施细则》。

本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上〔2023〕110号)、中国证券业协会发布的《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号),请投资者关注相关规定的变化,关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

本次发行价格8.90元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为20.99倍,低于中证指数有限公司2023年12月14日发布的行业最近一个月平均静态市盈率33.16倍,亦低于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率23.05倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份处理等环节,具体内容如下:

1. 初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据《大连达利凯普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于10.96元/股(不含10.96元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为10.96元/股,且申购数量小于2,000万股(不含2,000万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为10.96元/股,且申购数量为2,000万股,且申报时间同为2023年12月14日14:48:48:667的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成配售对象顺序,从后到前剔除3个配售对象。以上过程共剔除73个配售对象,剔除的拟申购总量为131,580万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和13,106,250万股的1.0039%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2. 发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为8.90元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者申购时无需缴付申购资金。本次网下发行网上和网下申购,均按时间优先原则进行。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年12月20日(“T”日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 本次发行价格为8.90元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)(全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)(基本养老保险基金(以下简称“养老金”)(企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)(符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)(和合格境外机构投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者,即兴证资管鑫众达利凯普1号员工战略配售集合资产管理计划(以下简称“达利凯普员工资管计划”)和中国保险投资集团(有限合伙)(以下简称“中保投基金”)。根据最终确定的发行价格,达利凯普员工资管计划最终战略配售股份数量为3,932,584股,约占本次发行数量的6.55%;中保投基金最终战略配售股份数量为7,415,730股,约占本次发行数量的12.36%。

本次发行初始战略配售数量为12,002,000股,占本次发行数量的20.00%。最终战略配售数量为11,348,314股,约占本次发行数量的18.91%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额653,686股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

4. 限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%向上取整计算,限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,达利凯普员工资管计划和中保投基金获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

5. 网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

6. 发行人和保荐人(主承销商)在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2023年12月20日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

7. 网下投资者应根据《大连达利凯普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年12月22日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《大连达利凯普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年12月22日(T+2)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。

8. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

9. 本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目网下询价和配售业务;网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

10. 发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2023年12月19日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网、中国金融新闻网和中国日报网上的《大连达利凯普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”),充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

## 估值及投资风险提示

1. 本次发行价格为8.90元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1) 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),达利凯普所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2023年12月14日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为33.16倍,请投资者决策时参考。

截至2023年12月14日(T-4日),可比A股上市公司的市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	T-4日收盘价 (元/股)	2023年12月 14日(元/股)	2022年扣 非前EPS (元/股)	2022年扣 非后EPS (元/股)	2022年扣 非前市盈 率(倍)	2022年扣 非后市盈 率(倍)
603267.SH	鸿远电子	51.55	3.47	3.38	14.87	15.26	
000636.SZ	风华高科	14.30	0.28	0.05	50.59	275.79	
603678.SH	炬芯电子	26.11	1.75	1.68	14.95	15.56	
300726.SZ	芯达电子	30.76	2.07	1.83	14.87	16.79	
300408.SZ	三环集团	28.40	0.79	0.64	36.17	44.59	
	平均值(剔除风华高科后)				20.22	23.05	

资料来源:WIND数据,截至2023年12月14日(T-4日)  
注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;  
注2:2022年扣非前后EPS=2022年扣除非经常性损益前后归母净利润T-4日总股本;

本次发行定价合理性说明如下:  
①公司发行契合国家产业政策,产品为先进制造产业链自主可控重要元器件

公司的主营业务及其发展战略契合国家产业政策导向,产品属于国内电子元件产业发展、实现先进制造产业链自主可控所鼓励的细分行业领域。

公司产品射频频微波瓷介电容器广泛应用于民用工业产品和军工产品的射频频微波电路之中,是不可或缺的基础电气元器件。与低频电路相比,射频频微波电路的应用场景主要为移动通信基站设备、半导体射频电源及激光设备、医疗影像设备、军用设备、轨道交通信号设备及仪器仪表等高端领域,部分下游行业处于快速发展阶段,均为国民经济发展与国家安全保障的重要领域。

②公司掌握射频频微波MLCC全流程制造技术和工艺,铸就扎实技术竞争优势

MLCC产品生产工序多,制造过程复杂,干式流延工艺流程中需要经历陶瓷浆料配料、流延、印刷、叠层、烧结等十余道相互衔接的工序,每道工序涉及特定配方、工艺和设备调节等环节以保障产品的质量和一致性。经众多工艺流程后,要实现产品的高品质、高一致性、高良率、多品种多型号的难度较大。

公司拥有多年的技术研发积累,具有较强的产品开发和生产能力,构建了完善的射频频微波MLCC研发和生产体系,在以下方面形成了公司的技术竞争优势:

技术领域	公司技术特点	发挥作用
原材料配方	掌握各型号产品陶瓷浆料、粘合剂等配方	掌握基础原材料工艺,通过调整原材料配方满足后续产品技术特征需求
关键技术	电容器结构设计	应用于高Q值、射频频微波多层片式瓷介电容器,保证产品高Q值、高射频频耐压
共烧技术	MLCC由陶瓷体、内电极金属和外电极金属构成,能够使不同材料烧结速率一致	陶瓷介质和电极金属不分层、不开裂,产品质量高,一致性好
研发设计	能够把握射频频微波瓷介电容器产品的容差、耐压等参数的调控工艺	满足各行业客户各类型产品定制化需求,同一产线生产各型号产品,拓展了产品应用领域
制造工艺	由于标准化设备不足以满足企业生产需求,根据工艺对标准化设备进行改造调整,已达到制造工艺和设备、材料的适配,以实现大批量工业化生产	满足客户对可靠性、一致性、交付周期和价格需求

公司通过多年积累和研发掌握了上述关键技术、研发设计和制造工艺,行业新进入者短期内无法快速掌握并实现批量生产。公司通过掌握射频频微波MLCC全流程制造技术和工艺,形成了扎实技术壁垒。目前,公司拥有33项专利技术(其中发明专利11项,实用新型专利22项),12项计算机软件著作权。此外,经过多年持续投入和经验积累,公司已经在生产与工艺领域形成了多项核心技术。

③公司下游工业设备应用领域品质要求高,具备突出的客户资源竞争优势

射频频微波MLCC产品的主要应用领域为通信基站、核磁共振医疗、激光、轨道交通、军工电子等工业设备的射频频微波电路之中,是不可或缺的基础电子元器件。上述领域的客户对产品性能及稳定性等品质的要求苛刻,但形成稳定供货之后其切换难度较大,切换时间长,成本高,因此该类客户倾向于与成熟供应商长期紧密合作。同时,射频频微波MLCC产品在所应用领域终端设备的成本结构中占比低,该类客户对其价格敏感性相对较低,而更看重其产品结构参数、技术指标和批次的一致性是否满足相应品质要求。

经过多年的发展,公司已成为国内射频频微波MLCC领域具有一定影响力的供应商,在其下游相应应用领域中与相关行业知名客户建立了稳定的业务关系。公司的客户主要包括客户A等国内移动通信主设备制造商,飞利浦、西门子等全球知名的高端医疗设备制造商,中国电科集团等科研单位。公司凭借优质可靠的产品赢得客户认可,形成了良好示范效应。多年积累的客户基础为公司构建了竞争壁垒,同时为将来在该行业内赶超国内外知名竞争对手、在国产化替代进程中占据市场份额奠定了扎实的基础。

④公司积极对标国际龙头产品,具备国产化优势

长期以来,国内射频频微波MLCC市场由国外企业占据主导地位,其中美国ATC公司的射频频微波MLCC产品在军工、医疗等领域占有较大市场份额,日本村田的射频频微波MLCC产品在通讯、汽车电子领域占有较大市场份额,国内企业竞争力有限。经过多年发展,公司产品型号和性能日臻完善,逐步实现对ATC公司和日本村田在射频频微波MLCC产品领域的对标和覆盖。

公司射频频微波MLCC产品生产的全流程均在国内进行,在产品品质和成本的保障下,具备较强的国际市场竞争力,远销美国、日本、欧洲等电子元件生产技术先进的发达国家地区,借助在国际市场地位,在国内国产化竞争中争取先机。同时,随着国内电子产业链国产化进程的加速,公司国产化优势得到进一步强化。

根据《2023年版中国MLCC市场竞争研究报告》,2022年全球射频频微波MLCC市场中,公司市场占有率位列全球企业第5位,中国企业第1位,是为数不多的具有国际市场射频频微波MLCC产品供应能力的中国企业之一。

⑤公司拥有产品规格及下游应用领域齐全的优势

公司射频频微波MLCC产品主要可分为三种类型:第一类为片式射频频微波MLCC,其又细可分为两类,即以钎焊为内电极的DLC70系列片式射频频微波MLCC和以银为内电极的DLC75系列片式射频频微波MLCC;第二类为微带射频频微波MLCC,由片式射频频微波MLCC焊接带状金属引脚、线状金属引脚而成;第三类为射频频微波MLCC功率组件,由多个片式射频频微波MLCC以串联并联形式焊接而成。

从产品容值来看,同样尺寸下,发行人产品容值范围与竞品范围相近,部分型号如DLC70A、DLC70B可以在相同尺寸做到容值更高,即该尺寸产品可以提供更高容值的型号满足特定需求,发行人产品规格的齐全性突出。

就下游应用领域而言,公司凭借优异的产品性能和服务能力,与多家知名移动通信基站设备、医疗影像设备、军用设备、轨道交通信号设备、半导体射频电源及激光设备和仪器仪表生产商建立了合作关系,产品应用领域丰富齐全。民品方面,在移动通信基站设备领域,公司已实现对国内主要移动通信基站设备商的批量供货;在医疗影像设备领域,公司与通用医疗(GE Healthcare)、西门子医疗(Siemens Healthineers)、联影医疗等大型医疗影像设备制造商保持长期合作关系;轨道交通信号设备领域,公司已成为中国通号的射频频微波MLCC供应商;半导体射频电源及激光设备领域,公司已进入Advanced Energy Industries、MKS Instruments、Inc.等知名半导体、电源技术公司的供应体系。在军用设备领域,公司具有完善的质量管理体系,拥有高可靠、定制化能力和生产全流程自主可控等优势,已获得《装备承制单位资格证书》《武器装备科研生产备案凭证》和《二级保密资格单位证书》等军工产品研发生产资质。

⑥公司具有突出的产品认证及市场准入壁垒优势

在民用工业市场领域,射频频微波MLCC在形成稳定供货之前需要经过产业链多层次对产品的性能、质量、交付保障等方面的严格考核认证,公司射频频微波MLCC产品已进入通信、医疗、轨道交通等行业知名生产商供应系统。

在军工市场领域,电子元器件厂商需取得相关部门颁发的军工资质,该资质的审查具有严格的标准,对射频频微波MLCC行业的潜在竞争者具有较高的进入门槛。公司已通过了武器装备质量管理体系认证,取得了装备承制单位资格证书、武器装备科研生产备案凭证、武器装备科研生产单位二

级保密资格证书等军工资质。公司经过多年在军工领域的深耕,军工销售业绩实现了较快的增长,形成了一定市场准入壁垒优势。

⑦公司具备持续盈利能力与较好的成长性

成立以来,发行人即持续深耕射频频微波MLCC行业。2018年以来,受益于下游领域需求增长及公司产品和技术优势,公司凭借优异的产品性能和服务能力,与多家知名移动通信基站设备、医疗影像设备、军用设备、轨道交通信号设备、半导体射频电源及激光设备和仪器仪表生产商建立了合作关系,公司的整体经营业绩实现了快速增长,具体如下:

项目	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
营业收入	47,698.37	35,444.38	21,585.38	16,158.26	15,257.63
归属于母公司股东的净利润	17,673.83	11,417.16	4,906.96	4,241.82	5,693.28
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	16,961.49	9,913.27	7,087.96	5,600.24	5,547.32

2018年-2022年,公司营业收入从15,257.63万元增长至47,698.37万元,年度复合增长率达32.97%;归属于母公司股东的净利润从5,693.28万元增长至17,673.83万元,年度复合增长率达32.74%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润从5,547.32万元增长至16,961.49万元,年度复合增长率达32.23%。此外,2022年相比2020年,公司营业收入、归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别增长了120.98%、260.18%和139.30%。

⑧公司具有质量管理体系建设优势

公司股东及管理层高度重视经营过程中的数字化、精细化管理,持续不断引入业内先进管理经验和管理人才。公司先后通过了GJB9001C-2017 国军标质量管理体系和GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系的认证,建立了较为完善的组织机构和经验丰富的管理团队。公司在生产、质量、供应链配套等方面不断积累锤炼适应公司快速发展和国内外市场竞争的管理经验,随着公司规模不断扩大,该等宝贵的管理经验将发挥更大的作用。

本次发行价格8.90元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为20.99倍,低于中证指数有限公司2023年12月14日发布的行业最近一个月平均静态市盈率33.16倍,亦低于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率23.05倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

⑨根据本次发行确定的发行价格,本次网下发行提交有效报价的投资者数量为294家,管理的配售对象数为6,487个,占剔除无效报价后所有配售对象总数的93.55%;对应的有效拟申购数量总和为12,233,660万股,占剔除无效报价后拟申购总量的93.34%,对应的有效申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的3,132.00倍。

⑩提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见本公告附表“初步询价报价情况”。

⑪《大连达利凯普科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为44,924.32万元,本次发行价格8.90元/股对应募集资金总额53,408.90万元,高于前述募集资金需求金额。

⑫本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑余价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及其所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低9.7146元/股。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

⑬投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2. 根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商确定,本次公开发行新股60,010,000股,本次发行全部为新股,不安排老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金44,924.32万元。按本次发行价格8.90元/股计算,发行人预计募集资金总额为53,408.90万元,扣除发行费用8,609.94万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为44,798.96万元。如存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

3. 发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

## 重要提示

1. 达利凯普首次公开发行60,010,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2023〕1890号)。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。发行人股票简称“达利凯普”,股票代码为“301566”,该简称和代码同时用于本次发行的初步询价及网上网下申购。

2. 发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行新股数量60,010,000股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为15.00%,全部为新股发行,无老股转让。本次公开发行后总股本为400,010,000股。

本次发行的初始战略配售数量为12,002,000股,占本次发行数量的20.00%。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。